**國家中山科學研究院材料暨光電研究所**

**109年度第二次專案人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

需求全時工作人員研發類50員、技術生產類38員，共計88員，依「國家中山科學研究院材料暨光電研究所109年度第二次專案人力進用員額需求表」辦理（如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院**新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。**

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)得依條件申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(持國外學歷者須符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格)。

(一)研發類：

1.碩士(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

3.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術生產類：

1.高中(含)以上畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核 薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用三個月內，本院始查覺者，得取消錄取資格︰

(一)履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(三)無行為能力或限制行為能力者。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。但情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。但情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用者。

(九)褫奪公權尚未復權者。

(十)受監護宣告尚未撤銷者。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員

資遣者。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之處分者。

**肆、報名時間及方式：**

一、甄試簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (http://www.ncsist.org.tw)，公告報名至109年7月6日止。

二、 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw)填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，各項資料並依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳。

三、需求單位於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後

，辦理初步選員(資格審查)。

四、報考人員經初步選員 (資格審查)合格者，需求單位以電子郵件或簡訊或Line (擇一)通知參加甄試。

五、不接受紙本及現場報名甄試。

六、應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，僅需繳交學生證掃描檔查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發錄取通知日起至報到日期間，繳驗畢業證書正本(如為學校因素無法如期繳交，須出具學校開立之佐證證明)，若無法繳驗，則取消錄取資格。

七、歡迎具身心障礙身分或原住民族身分，且符合報考資格者報名參加甄試，並於人才資料庫登錄資料時註記。

八、為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件3)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**各項資料依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳。 報考職缺每人最多以三個為原則。**

一、填具履歷表(如附件2），並依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院則予不經預告終止契約解除聘雇。

二、主管核章之各類聘僱員工參加招考報名申請表掃描檔(如附件3，僅本院同仁需繳交)。

三、符合報考學歷之畢業證書掃描檔。

四、報考所需之個人掃描檔資料(如：工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績(同等語文能力測驗標準表如附件4)，請參考簡章之員額需求表)。

五、提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。

六、若有繳交非我國政府機構之工作經歷證明，需再檢附個人社會保險投保證明(如：勞保、公保、農保…等)，如未檢附，該工作經歷不予認可。

七、具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。

八、具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

一、甄試日期及時間：暫定109年 7月 (實際甄試時間以甄試通知為準)。

二、甄試地點：暫定桃園市龍潭區中科院新新或龍門院區(實際甄試地點以甄試通知單為準)。

三、甄試方式：

(一)研發類：

1.初試：書面審查與口試(配分請參考員額需求表)。

2.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

(二)技術生產類：

1.初試：實作與口試(配分請參考員額需求表)。

2.複試：口試(配分請參考員額需求表)。

1. 各項甄試作業如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理的調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊或Line通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號、手機號碼及Line。若以電子郵件、簡訊、Line通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 研發類書面審查不合格者及技術生產類書面審查或筆試/實作不合格者，皆不通知參加口試。
4. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

一、單項(書面審查/實作/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。

二、初、複試(口試)合格標準為70分(滿分100分)。

三、總成績合格標準為70分(滿分100分)。

四、如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。

五、成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類、技術生產類、行政管理類：總成績為複試(口試)平均成績。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

2.技術生產類：依序以實作平均成績/筆試成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由單位決定錄取順序。

六、備取人數：

(一)完成各階段甄試後合格但未錄取之應徵者得設為備取人員，並由單位依成績排定備取順序，依序備取，儲備期限自甄試結果奉院長核定次日起4個月內有效。

(二)人員錄取或遞補來院報到後，其他於本院應徵職缺之錄取或遞補皆視同自動放棄。

**捌、錄取通知：**

一、甄試結果預由本院於甄試後1個月內寄發通知單(或以電子郵件通知)，各職缺錄取情形不予公告。

二、人員進用：錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

總機：(03)4712201或(02)26739638

聯絡人及分機：材料暨光電研究所 林正裕組長357010

黃瑞婷小姐357231

劉佳珊小姐357268

line@帳號：@hwi9801m

(相關甄試期程亦會line上通知，請加入line以利聯繫。)

附件1

| **國家中山科學研究院材電所109年第二次專案人力進用員額需求表** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作編號** | **需求**  **單位** | **職類** | **學歷**  **需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作**  **地點** | **甄試**  **方式** |
| **1** | 材電 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 機械/材料 | 1.材料/化學/紡織/纖維/高分子/機械/自動化/控制/航空/造船/光學/工業工程等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次：  <一>  1.半導體元件製程開發。  2.黃光微影製程、乾/濕式蝕刻、金屬蒸鍍等製程與元件特性量測工作。  <二>  1.金屬熔煉、鑄造技術及製程開發。  2.絕熱塗層材料及製程技術開發。  3.超合金方向性凝固鑄造製程技術開發。  <三>  1.複合材料結構開發與研製。  2.複合材料製程設計開發。  3.高溫熱防護材料研發。  4.特殊材料開發。 | 3 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **2** | 材電 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  |  85,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊/電信/通信(訊)/控制/光電/物理/天文/航空/生醫/醫工等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次：  <一>  1.影像處理演算法開發與程式驗證（具影片中物體偵測、追蹤法則及程式開發經驗為佳）  2.DSP嵌入式軟體開發與測試（熟TI DSP為佳）。  3.C與Matlab軟體開發（具程式優化經驗者為佳）。  4.韌體程式開發及測試。  <二>  1.微處理器/DSP應用電路開發與測試。  2.數位電路設計與測試。  3.光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  4.視訊訊號介面轉換設計。  5.數位控制設計與測試。  6.伺服硬體控制電路設計。  <三>  1.光電系統設計、分析、測試之規劃及執行。  2.目標、背景等光電特性之模擬、量測與分析。  3.光電系統訊雜比、偵測率及誤差分析。 | 1 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **3** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 光電/光學 | 1.電子/電機/光電/物理/天文/太空/生醫等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次：  <一>  1.光電系統設計分析測試之規劃及執行。  2.光電系統光軸組裝調校與系統性能測試。  3.目標、背景等光電特性之模擬量測與分析。  4.光電系統訊雜比、偵測率及誤差分析  <二>  1.成像、雷射光學設計。  2.Code V、Zemax、LightTools、Sollidworks軟體操作。  3.光路架設與調校。 | 5 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **4** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 糸統整合/系統測試/軟體開發 | 1.電子/電機/資訊/電信/通信(訊)/光電/物理/天文/航空/生醫/醫工等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次：  1.光電系統設計分析測試之規劃及執行。  3.自動化測試設備開發、人機介面開發與控制程式撰寫。  2.測試裝備軟硬體維護。  3.頭戴式顯示系統開發、測試。  4.系統((測試)軟體及跨平台程式開發。  5.光纖通訊設備開發及測試。  6.光電系統整合及測試。  7.顯示系統開發及測試。 | 6 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **5** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 信號/影像 | 1.電子/電機/資訊/電信/電訊/通訊/控制/機械等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次：  <一>  1.PCB電路設計(元件選用、特性分析、設計、測試及除錯)。  2.電路板規劃、分析、介面協調、整合。  <二>  影像處理演算法開發設計與嵌入式系統C語言程式設計  <三>  1.執行自適應光學系統整合。  2.Labview程式開發。  3.微處理器韌體程式開發。  4.信號處理或光學系統演算法開發。 | 5 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **6** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機電 | 1.電子/電機/資訊/通訊/電信/電訊/控制/機電/動力機械/機械等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，另配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作：  <一>  1.微處理器/ DSP應用電路開發與測試。  2.數位控制設計與測試。  3.伺服硬體控制電路設計。  4.電源模組設計及分析。  5.佈線設計及電路規劃。  <二>  1.微波元件電性設計、量測及優化。  2.電性測試系統開發研究。  <三>  1.武器系統電力電機系統開發設計。  2.武器系統自動控制/馬達控制系統開發設計。  3.武器產品機構設計與結構分析。  4.機電整合與系統測試。  5.結構設計及應力/靜力/動態分析。  <四>  1.雲台伺服穩定。  2.鏡頭馬達控制。  3.人攜式觀測系統軟韌體開發。 | 10 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **7** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/自動化/應用力學/光電/航空/造船/機電/控制/精密工程/工科學等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，另配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作：  <一>  1.光電產品機構設計、機電整合與系統測試。  2.機械動件設計、系統機構設計、模組機構設計。  3.光電裝備研發過程相關測試。  4.變焦鏡頭光機/系統機構設計。  <二>  1.機械系統或模組之設計開發。  2.複合材料結構設計。  3.結構分析、開發與測試。  4.機械製造檢驗、品管與設備保護維護。  <三>  1.散熱模組之設計與規劃。  2.結構熱傳之設計與分析。  3.機械系統或機械模組之設計開發。  4.機械結構模組之設計與規劃。  5.光電產品封裝設計、測試與製程整合。 | 10 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **8** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/材料  化學/化工 | 1.機械/自動化/控制/航空/模具/造船/光學/工業工程/材料/化學/紡織/纖維/高分子等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中級/TOEIC 550分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，另配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作：  <一>  1.碳/碳與陶瓷複合材料製程開發。  2.煞車碟盤製程開發。  3.複合材料測試驗證評估。  <二>  1.半導體材料及元件製程開發與量測。  2.半導體基才製備及製程優化。  3.陶瓷鍍膜技術開發研究。  4.產品製程規劃、介面協調、技術資料整建、專案計畫管制。  <三>  1.金屬熔煉、鑄造技術及製程開發。  2.超金合方向性凝固鑄造製程技術開發。  3.金屬粉末氣體霧化製程模擬分析及製造技術開發。  4.金屬積層製造技術及製程開發。  5.絕熱塗層材料及製程技術開發。  <四>  1.高溫機性、破壞韌性、疲勞、潛變…等機械性質評估。  2.高溫熱防護材料研發。  3.材料性質檢測及材料失效分析評估。  4.逆向工程分析。  5.特殊材料開發。  6.電池材料製程。 | 7 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **9** | 材電 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 專案管理/  系統工程 | 1.電子/電機/機械/光電/航空/造船/自動控制/工業工程等相關理工系所畢業。  2.具全民英檢中高級/TOEIC 750分以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  3.具工作內容任何一項工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)學士(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等文件。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次：  1.專案管理執行、專案建案、生產規劃與管制、合約管理等相關管制及系統整合工作。  2.資源分配、時程管制、風險管理與流程改善，品質稽核等工作。  3.計畫、預算管理。 | 3 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **10** | 材電 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 電子/電機 | 1.學經歷條件：  (1)電子/電機/資訊/電訊/通訊/電信/光電/機電/工業工程/物理等相關理工科系畢業。  (2)未具上述理工科系者需從事相關工作經驗1年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  <一>  1.執行光電模組製作及測試、線路圖繪製與佈線配接、機台操作與維護工作。  2.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  3.電路板焊接、組裝及測試。  4.電路板布局及布局系統維護。  <二>  1.光電系統測試規劃及驗測。  2.光電系統組裝及測試。  3.觀測系統對光、調校。  4.測試及介面軟體開發及測試維護。  5.雷射組裝對光工作。  6.光纖通訊檢測、光纖佈線規劃。  <三>  1.武器系統組裝、測試。  2.軟體/電路測試。  <四>  放電測試 | 11 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  1.電子電路錫焊。  2.示波器或電表等儀器操作。  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **11** | 材電 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械 | 1.學經歷條件：  (1)機械/自動化/控制/航空/模具/鑄造/造船/光學/工業工程/海洋工程/水利/工程科學/製造工程/工業設計等相關理工科系畢業。  (2)未具上述理工科系者需從事相關工作經驗1年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.光學系統組裝與調校。  2.光機設計。  3.機械繪圖/加工。  4.機械加工(含鉗工)。 | 2 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  車床  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **12** | 材電 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械/材料  化學/化工 | 1.學經歷條件：  (1)機械/自動化/控制/航空/模具/造船/光學/工業工程/材料/化學/紡織/纖維/海洋工程/水利/工程科學/製造工程/工業設計等相關理工科系畢業。  (2)未具上述理工科系者需從事相關工作經驗1年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，另配合工作需求，需於桃園龍潭及新北三峽兩地工作，並可配合輪班、調班、出差。  <一>  1.材料進料檢驗、製作、加工與性質檢驗  2.零組件檢測、組裝與膠合。  3.複合材料編織製作、檢測、組裝與膠合  4.粉末成型、燒結、熔膠與檢測。  5.高溫與高壓設備操作及保養維護。  6.電池材料製程。  7.模治具設計與繪圖。  <二>  1.複合材料成型製作、燒結、檢測、組裝與膠合。  2.熱壓成型與高溫設備操作及保養維護。  3.模治具設計。  <三>  1.合金熔煉及鑄造。  2.砂模及精密鑄造造模。  3.鑄件缺陷去除、銲補、修磨。  4.鑄件熱處理後整型及尺寸量測。  5.機性試桿及簡易手工具製作等機械加工。  6.製程夾模治具設計與製作。  <四>  1.材料機械性能測試。  2.高溫材料性質測試。  3.高溫熱防護材料製作。  4.機械加工。  5.NDT檢測。  6.材料檢測分析(含游離輻射)設備操作及檢測報告撰寫。  7.專案計畫工作。 | 12 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  機械識圖  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **13** | 材電 | 技術類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械 | 1.學經歷條件：  (1)機械/自動化/控制/航空/模具/鑄造/造船/光學/工業工程/海洋工程/水利/工程科學/製造工程/工業設計等相關理工科系畢業。  (2)未具上述理工科系者需從事相關工作經驗1年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)專科(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.機械製圖、機械/光學組裝、檢測及機械性質量測。  2.機械加工(含鉗工)。  3.製程夾模模治具設計與製作。  4.鏡片製作與檢測。  5.鏡片鍍膜與檢測。  6.光學系統組裝與調校。  7.生產支援、物管及備料。 | 3 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  車床  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **14** | 材電 | 技術類 | 高中職  畢業 | 30,900  |  37,000 | 電子/電機 | 1.學經歷條件：  (1)理工科系(電子/電機/資訊/電訊/通訊/電信/光電/機電/工業工程/物理尤佳)等相關理工科系畢業，需從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關工作經歷證明)。  (2)未具理工科系者需具工作內容相關乙級證照且從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關乙級證照及工作經歷證明)2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)高中職(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.光電系統電路測試。  2.光電系統組裝及測試。  3.電路板及接頭線路錫焊。  4.光纖通通器測試/光纖捲線器組裝及測試。  5.系統測試/觀測系統對光調校。  6.雷射組裝對光工作。  7.生產管理相關工作。 | 3 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  1.電子電路錫焊。  2.示波器或電表等儀器操作。  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **15** | 材電 | 技術類 | 高中職  畢業 | 26,000  |  30,000 | 機械 | 1.學經歷條件：  (1)機械/自動化/控制/航空/模具/鑄造/造船/光學/工業工程/海洋工程/水利/工程科學/製造工程/工業設計等相關理工科系畢業。  (2)未具上述理工科系者需從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)高中職(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.機械製圖、機械/光學組裝、檢測及機械性質量測。  2.機械加工(含鉗工)。  3.進料檢驗。  4.光學元件檢測。  5.鏡片製作與檢測。  6.鏡片鍍膜與檢測。  7.對光、參數設定與ESS環測測試。  8.電池材料製程。 | 1 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  車床  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **16** | 材電 | 技術類 | 高中職  畢業 | 30,900  |  37,000 | 機械/材料 | 1.學經歷條件：  (1)理工相關科系畢業(機械/自動化/控制/航空/模具/造船/光學/工業工程/材料/化學/紡織/纖維/海洋工程/水利/工程科學/製造工程/工業設計尤佳)，需從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  (2)未具理工科系者需具工作內容相關乙級證照且從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關乙級證照及工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)高中職(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.合金熔煉及鑄造。  2.砂模及精密鑄造造模。  3.機性試桿及簡易手工具製作等機械加工(車、銑、鑽、鉗)。  4.製程夾模治具設計與製作。  5.相關生產支援、鑄件道次轉移運輸、物管及備料。 | 3 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  砂模製作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **17** | 材電 | 技術類 | 高中職  畢業 | 30,900  |  37,000 | 機械/材料 | 1.學經歷條件：  (1)理工相關科系畢業(機械/自動化/控制/航空/模具/造船/光學/工業工程/材料/化學/紡織/纖維/海洋工程/水利/工程科學/製造工程/工業設計尤佳)，需從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關工作經歷證明)  (2)未具理工科系者需具工作內容相關乙級證照且從事相關工作經驗10年以上。(需檢附相關乙級證照及工作經歷證明)  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)高中職(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.合金熔煉及鑄造。  2.砂模及精密鑄造造模。  3.鑄件缺陷去除、銲補、修磨。  4.鑄件熱處理後整型及尺寸量測。  5.機性試桿及簡易手工具製作等機械加工。  6.製程夾模治具設計與製作。 | 1 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  氬焊  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| **18** | 材電 | 技術類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 物料管理/資訊管理/專案管理 | 1.電子、電機、電信、電訊、通訊、資訊、材料、化學、化工、高分子、地球科學、工程科學、工業工程、物理、數學、計算機、網路、多媒體、電腦、數位、控制、光電、自動化、顯示科技、半導體、機電、機械、車輛、航空、飛機、模具、製造工程、應用力學、精密、動力、土木、奈米科學、工業工程、紡織、纖維、測量、環境、河海、水利、生醫、影像、核子、冷凍空調、印刷、礦冶、醫學、放射等理工科系畢業。  2.具有全民英檢中級/TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上，如為國外大學以上學歷畢業，則免具英文檢定證明(需檢附證明資料)。  2.具相關工作內容經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)其它有助審查資料之文件。 | 依個人專長從事以下工作內容部份項次，並可配合輪班、調班、出差。  1.生產製程排程、工令與進度管制，生產管理等相關工作。  2.財產管理、物品管理、物料管理、物流管理等相關工作。  3.資訊、通訊相關業務(資訊安全、網路管理、伺服器管理、資訊設備規劃及維運、網頁維護。)  4.科技專案管理執行協調、計畫管理、預算分析。  5.可配合輪班、調班、出差。 | 2 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **實作50%**  Access+Excel  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 合計：研發類50員、技術類38員，合計88員 | | | | | | | | | | |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 簡要自述(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

學歷如為碩士請加附學士畢業證書

(請貼上畢業證書圖檔)

二、學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

三、學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

四、英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

五、具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

六、相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

七、其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

(請貼上補充資料圖檔)

**履歷表補充附表**

**填表日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ★**姓名** | | |  | | | | | | | |
| **2** | ★**報考職類** | | | □研發類　 □技術類　 □行政、管理類 | | | | | | | |
| **3** | ★**報考項次**  **(報考至多3個職缺為原則)** | | |  | | | | | | | |
| **4** | **前一份工作月薪** | | | 元 | | | **前一份工作年薪** | | 元 | | |
| **5** | ★**預期月薪** | | | 元 | | | ★**可接受最低月** | | 元 | | |
| **6** | **語言能力** | | |  | | | | | | | |
| **7** | **專長** | | |  | | | | | | | |
| **8** | **本院產學合作案或其他合作計畫** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 計畫名稱 |  | | | 期程 | 至 | | 本院合作單位 | | |  |
| **9** | **證照** | | | | | | | | | | **計\_\_\_\_張** |
| **10** | **論著** | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **碩士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.2** | **博士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.3** | **國內外學術期刊發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.3.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 發表期刊名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.4** | **國內外研討會發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.4.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 研討會名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.5** | **其他著作** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.5.1 | 著作名稱 | |  | | | | | | | | |

(本表若不敷使用請自行延伸) 備註：有★為必填欄位

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或工作編號) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。

附件4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 同等語文能力測驗標準表 | | | |
| 全民英檢 | 多益(TOEIC) | 托福  (TOFEL ITP) | 雅司  (IELTS) |
| 優級 | 950(含)以上 | 630(含)以上 | 7.5(含)以上 |
| 高級 | 880(含)以上 | 560(含)以上 | 6.5(含)以上 |
| 高/中級 | 750(含)以上 | 527(含)以上 | 5.5(含)以上 |
| 中級 | 550(含)以上 | 457(含)以上 | 4(含)以上 |